

Schablonenreiniger – ready-to-use

SYS-CLEAN[®] STC4.0 ist ein Reinigungsmedium zur Reinigung von SMT-Druckschablonen bereits bei Raumtemperatur.

SYS-CLEAN[®] STC4.0 reinigt zuverlässig Lotpasten und insbesondere SMT-Kleber in einem Prozess. Problematische Pigmentrückstände der SMT-Kleber entfernt der Reiniger vollständig.

SYS-CLEAN[®] STC4.0 ist ebenfalls für die Reinigung von fehlbedruckten Baugruppen geeignet.

Der Reiniger kann sowohl im Sprühverfahren als auch in Tauch- oder Ultraschallanlagen eingesetzt werden.



Anwendungsbereich

Verschmutzung	Eignung
Lotpasten	✓ ✓
SMT-Kleber bzw. Leitkleber	✓ ✓
Flussmittel	✓
Öle/Fette	✓

Anwendungsparameter

Parameter	
Anwendungstemperatur	20°C
Reinigungsdauer ca.	4-6 min.
Spülung	VE-Wasser
Trocknung	Konvektion / Druckluft
Einsatzkonzentration	ready-to-use

✓ ✓ = Exzellent ✓ = Optimal ○ = Optional ✗ = Nicht Empfohlen

Technische Daten

SYS-CLEAN[®] STC4.0 wird als Fertigmischung ausgeliefert.

pH-Wert	8,2
Dichte (bei 20°C)	0,959 g/cm ³
Brechungsindex (bei 20°C)	1,4321
Siedebeginn und Siedebereich	>200 °C
Flammpunkt	>100 °C

Schablonenreiniger – ready-to-use

Anwendungsart	
Sprühreinigung	✓ ✓
Tauchreinigung – Perlator	✓ ✓
Tauchreinigung – Sprühsystem	✓ ✓
Ultraschallreinigung	✓ ✓
Manuell	✓

✓ ✓ = Exzellent ✓ = Optimal ○ = Optional ✗ = Nicht Empfohlen

Vorteile:

SYS-CLEAN[®] STC4.0 ist sehr gut filtrierbar und verfügt über ein optimiertes Ablaufverhalten wodurch sich der Verbrauch reduziert. Durch die hohe Beladungskapazität ist ein besonders kostengünstiger Prozess gewährleistet. Das Medium muss mit Wasser nachgespült werden.

Verfügbarkeit:

SYS-CLEAN[®] STC4.0 Fertiggemisch ist in folgenden Größen erhältlich
 Artikelnummer: 64902863 – 25L



Registration, Evaluation and
 Authorisation of Chemicals

Das Produkt ist frei von
 bedenklichen
 Inhaltsstoffen gemäß der
 SIN- & SVHC-Listen



100% konform mit den EU
 Richtlinien RoHS 1 & 2,
 WEEE